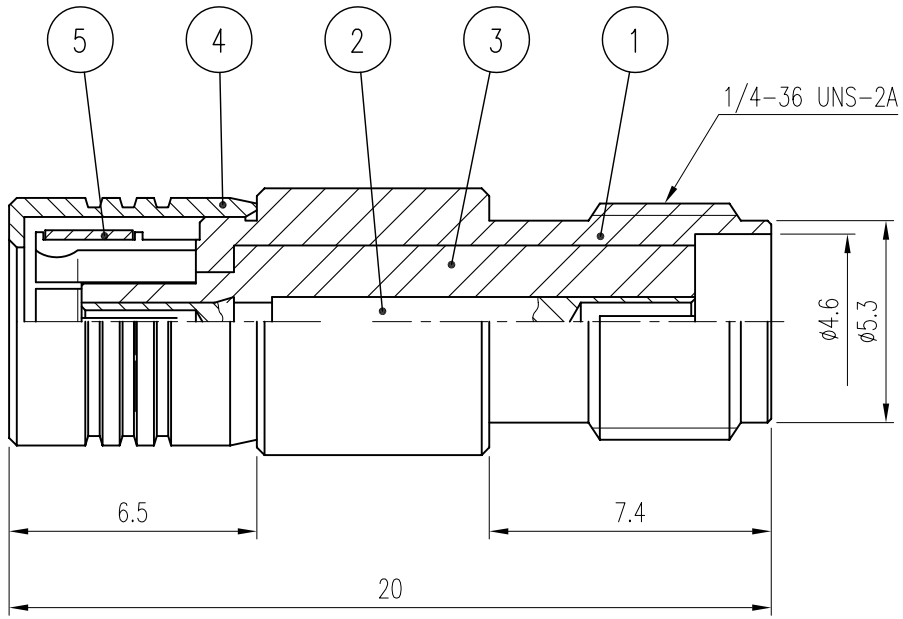
가공 / ST									
ST(기존)									
ST(개선)									

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
3	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-5/1 (R3001)
2	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00021-5/1 (K3001)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00017-N/1 (HA012)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00006-5/1 (EA038)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DAD00012-5/1 (DA045)

대체가능재질

공통공차 소수 각도 분수

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2002. 12. 28.

승인

검도

제도

직성부서 연 구 소

척도 5/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMAJ-SMBP

A4

도번 AD00160-7/1

K361-123-000